

中国汽车芯片市场需求分析及前景规划分析报告2024-2031年

产品名称	中国汽车芯片市场需求分析及前景规划分析报告 2024-2031年
公司名称	鸿晟信合（北京）信息技术研究院有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0530)（注册地址）
联系电话	010-84825791 15910976912

产品详情

【全新修订】：2024年1月

【出版单位】：鸿晟信合研究院

【内容部分有删减·详细可参鸿晟信合研究院出版完整信息！】

【报告价格】：[纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (可以优惠)

【服务形式】：文本+电子版+光盘

【联系人】：顾言

中国汽车芯片市场需求分析及前景规划分析报告2024-2031年

章 2021-2023年汽车半导体行业发展综合分析

1.1 汽车半导体基本概述

1.1.1 汽车半导体基本定义

1.1.2 汽车半导体主要分类

1.1.3 汽车半导体基本要求

1.1.4 汽车半导体价值构成

1.1.5 汽车半导体发展历程

1.2 全球汽车半导体行业发展现状

1.2.1 汽车半导体市场规模

1.2.2 汽车半导体产品结构

1.2.3 汽车半导体竞争格局

1.2.4 汽车半导体区域分布

1.2.5 汽车半导体应用情况

1.2.6 美国汽车半导体发展

1.2.7 欧洲汽车半导体市场

1.2.8 日韩汽车半导体市场

1.3 中国汽车半导体行业发展现状

1.3.1 汽车半导体市场规模

1.3.2 汽车半导体企业布局

1.3.3 中国汽车半导体实力

1.3.4 汽车半导体发展问题

1.3.5 汽车半导体发展建议

1.3.6 汽车半导体需求前景

1.4 中国汽车功率半导体行业发展状况

1.4.1 功率半导体基本介绍

1.4.2 IGBT生产工艺演变分析

1.4.3 IGBT市场竞争格局分析

1.4.4 IGBT典型应用场景分析

1.4.5 MOSFET市场竞争格局

1.4.6 功率半导体发展机遇

第二章 2021-2023年全球汽车芯片行业发展状况

2.1 2021-2023年全球汽车芯片市场运行分析

2.1.1 汽车芯片市场规模

2.1.2 汽车芯片价格变动

2.1.3 汽车芯片竞争格局

2.1.4 汽车芯片区域分布

2.1.5 汽车芯片企业布局

2.1.6 汽车芯片应用分析

2.2 全球各地区汽车芯片市场发展动态

2.2.1 美国

2.2.2 欧洲

2.2.3 日本

2.2.4 韩国

2.3 全球汽车芯片短缺状况及影响分析

2.3.1 全球汽车芯片短缺现状

2.3.2 全球汽车芯片短缺类型

2.3.3 汽车芯片短缺应对措施

2.3.4 全球汽车芯片供应展望

第三章 2021-2023年中国汽车芯片行业发展环境分析

3.1 经济环境

3.1.1 宏观经济运行

3.1.2 工业经济运行

3.1.3 固定资产投资

3.1.4 对外贸易分析

3.1.5 宏观经济展望

3.2 政策环境

3.2.1 汽车半导体政策

3.2.2 产业创新战略联盟

3.2.3 汽车芯片扶持政策

3.2.4 新能源车发展规划

3.2.5 智能网联汽车政策

3.3 汽车工业运行

3.3.1 行业发展形势

3.3.2 汽车产销规模

3.3.3 新能源汽车市场

3.3.4 外贸市场状况

3.3.5 汽车企业业绩

3.3.6 发展前景展望

3.4 社会环境

3.4.1 居民收入情况分析

3.4.2 居民消费支出分析

3.4.3 智能网联汽车发展

3.4.4 新能源汽车智能化

第四章 2021-2023年中国汽车芯片行业发展分析

4.1 中国汽车芯片行业重要性分析

4.1.1 汽车芯片主要类型

4.1.2 汽车芯片行业地位

4.1.3 汽车芯片自主可控

4.1.4 汽车芯片发展形势

4.1.5 汽车芯片发展必要性

4.2 2021-2023年中国汽车芯片市场现状

4.2.1 汽车芯片使用数量

4.2.2 汽车芯片市场规模

4.2.3 国产汽车芯片现状

4.2.4 汽车芯片的标准化

4.2.5 汽车芯片协同发展

4.3 中国汽车芯片市场短缺现状分析

4.3.1 汽车芯片短缺现状

4.3.2 芯片短缺影响分析

4.3.3 国产汽车芯片问题

4.3.4 汽车芯片短缺反思

4.4 2021-2023年中国汽车芯片市场竞争形势

4.4.1 汽车芯片相关企业数量

4.4.2 汽车芯片产业区域分布

4.4.3 汽车芯片厂商布局现状

4.4.4 汽车厂商芯片领域布局

4.4.5 汽车芯片赛道竞争态势

4.4.6 汽车芯片未来竞争格局

4.5 中国汽车芯片技术发展状况

4.5.1 汽车芯片工艺要求

4.5.2 汽车芯片研发周期

4.5.3 汽车芯片专利申请

4.5.4 车规级芯片技术现状

4.5.5 汽车芯片创新路径

4.6 中国汽车芯片行业发展困境分析

4.6.1 汽车芯片发展痛点

4.6.2 汽车芯片面临的挑战

4.6.3 车规级芯片亟待突破

4.6.4 汽车芯片自给率不足

4.7 中国汽车芯片市场对策建议分析

4.7.1 构建汽车芯片产业生态

4.7.2 汽车芯片产业发展建议

4.7.3 扶持汽车芯片产业

4.7.4 汽车芯片产业发展路径

第五章 2021-2023年中国汽车芯片细分领域发展分析

5.1 中国汽车微控制器（MCU）发展分析

5.1.1 MCU在汽车上的应用

5.1.2 全球汽车MCU芯片发展

5.1.3 中国MCU芯片市场规模

5.1.4 中国MCU应用领域占比

5.1.5 中国MCU芯片专利申请

5.1.6 中国汽车MCU芯片发展

5.1.7 中国汽车MCU短缺问题

5.2 中国汽车系统级芯片（SOC）发展分析

5.2.1 SOC芯片在汽车上的应用

5.2.2 自动驾驶用SOC芯片分析

5.2.3 智能座舱用SOC芯片分析

5.2.4 汽车用SOC芯片企业布局

5.2.5 汽车用SOC芯片技术难点

5.2.6 汽车用SOC芯片发展风险

5.2.7 汽车用SOC芯片发展建议

5.3 中国汽车存储芯片发展分析

5.3.1 汽车存储芯片发展概况

5.3.2 汽车用DRAM芯片分析

5.3.3 汽车用NAND芯片分析

5.3.4 汽车用NOR芯片分析

5.3.5 汽车用EEPROM芯片

5.3.6 存储芯片未来发展展望

5.4 其他汽车芯片发展分析

5.4.1 汽车通信芯片发展

5.4.2 汽车功率芯片发展

第六章 2021-2023年中国汽车芯片产业链发展解析

6.1 汽车芯片产业链发展综述

6.1.1 汽车芯片产业链结构分析

6.1.2 汽车芯片产业链企业图谱

6.1.3 汽车芯片产业链区域分布

6.1.4 芯片短缺对产业链的影响

6.1.5 汽车芯片产业链价格波动

6.1.6 汽车芯片产业链发展建议

6.2 汽车芯片行业供应链发展分析

6.2.1 汽车工业供应链变革

6.2.2 芯片企业供应链节奏

6.2.3 汽车芯片供应链问题

6.2.4 汽车企业供应链管理

6.2.5 欧美芯片法案的影响

6.3 汽车芯片上游材料及设备市场分析

6.3.1 半导体材料的主要类型

6.3.2 芯片短缺对光刻胶的影响

6.3.3 车用8英寸晶圆产能不足

6.3.4 晶圆代工厂扩产规划部署

6.3.5 晶圆代工厂商扩产的风险

6.3.6 半导体设备行业发展机遇

6.4 汽车芯片中游制造产业分析

6.4.1 汽车芯片产能现状分析

6.4.2 汽车芯片制造模式分析

6.4.3 汽车芯片制造商议价能力

6.4.4 芯片代工封测端景气度

6.5 汽车芯片下游应用市场需求分析

6.5.1 行业应用领域

6.5.2 整车制造市场

6.5.3 新能源车市场

6.5.4 自动驾驶市场

第七章 2021-2023年汽车芯片主要应用市场发展分析

7.1 ADAS领域

7.1.1 ADAS行业基本介绍

7.1.2 ADAS行业政策发布

7.1.3 ADAS行业发展规模

7.1.4 ADAS市场的渗透率

7.1.5 ADAS供应商布局情况

7.1.6 ADAS行业投融资分析

7.1.7 ADAS芯片发展动态

7.1.8 ADAS融合趋势分析

7.2 汽车传感器领域

7.2.1 汽车传感器相关介绍

7.2.2 汽车传感器发展历程

7.2.3 汽车传感器市场规模

7.2.4 汽车传感器市场结构

7.2.5 汽车传感器芯片需求分析

7.2.6 CMOS图像传感器芯片

7.2.7 汽车导航定位芯片分析

7.2.8 汽车车载雷达芯片分析

7.3 智能座舱领域

7.3.1 智能座舱行业相关介绍

7.3.2 智能座舱市场规模分析

7.3.3 智能座舱的市场渗透率

7.3.4 车企智能座舱产品配置

7.3.5 智能座舱芯片发展现状

7.3.6 智能座舱芯片参与主体

7.3.7 智能座舱芯片竞争格局

7.3.8 智能座舱行业发展趋势

7.4 车联网领域

7.4.1 车联网行业基本介绍

7.4.2 车联网相关利好政策

7.4.3 车联网行业发展规模

7.4.4 车联网行业的渗透率

7.4.5 车联网行业企业布局

7.4.6 车联网行业投融资分析

7.4.7 车联网产业发展前景

7.4.8 车联网下芯片需求趋势

7.5 自动驾驶领域

7.5.1 自动驾驶行业基本介绍

7.5.2 自动驾驶行业运行现状

7.5.3 自动驾驶芯片的供应链

7.5.4 自动驾驶芯片发展现状

7.5.5 自动驾驶芯片竞争格局

7.5.6 自动驾驶处理器芯片

7.5.7 自动驾驶AI芯片动态

7.5.8 国产自动驾驶芯片机遇

7.5.9 芯片未来竞争格局预判

第八章 2021-2023年中国汽车电子市场发展分析

8.1 中国汽车电子行业发展概述

8.1.1 汽车电子基本定义

8.1.2 汽车电子发展特点

8.1.3 汽车电子的产业链

8.1.4 汽车电子驱动因素

8.1.5 汽车智能计算平台

8.2 2021-2023年中国汽车电子市场发展分析

8.2.1 汽车电子规模现状

8.2.2 汽车电子市场结构

8.2.3 汽车电子成本变化

8.2.4 汽车电子的渗透率

8.2.5 汽车电子投融资动态

8.3 汽车电子市场竞争分析

8.3.1 一级供应商市场格局

8.3.2 ADAS系统竞争格局

8.3.3 车身电子竞争现状

8.3.4 车载电子系统竞争

8.3.5 区域竞争格局分析

8.4 汽车电子市场发展存在的问题

8.4.1 汽车电子标准化问题

8.4.2 汽车电子技术发展问题

8.4.3 汽车电子行业应用问题

8.4.4 汽车电子行业进入壁垒

8.5 中国汽车电子市场发展策略及建议

8.5.1 汽车电子行业政策建议

8.5.2 汽车电子产业发展建议

8.5.3 汽车电子企业发展建议

8.5.4 汽车电子供应链建设策略

8.6 中国汽车电子市场前景展望

8.6.1 汽车电子发展机遇

8.6.2 汽车电子发展趋势

8.6.3 关键技术应用趋势

8.6.4 汽车电子发展方向

第九章 2021-2023年国外汽车芯片重点企业经营分析

9.1 博世集团 (Bosch)

9.1.1 企业发展概况

9.1.2 汽车芯片布局

9.1.3 芯片项目动态

9.1.4 企业合作动态

9.1.5 企业收购动态